

Title (en)

Assembly kit for attaching an audio module to a rail system

Title (de)

Montagesatz zur Befestigung eines Audiomoduls an einem Schienensystem

Title (fr)

Jeu de montage pour la fixation d'un module audio à un système de rails

Publication

**EP 2793324 A1 20141022 (DE)**

Application

**EP 13164163 A 20130417**

Priority

EP 13164163 A 20130417

Abstract (en)

[origin: WO2014170256A1] The invention relates to an installation kit (1) for fastening an audio module (2) to a rail system. The audio module (2) has a carrier structure (4) having at least one suspension member (5) and at least one supply line (6) for an audio signal and the installation kit (1) has means for fastening the suspension member (5) of the audio module (2) to a multi-phase lighting rail (1) of a lighting rail system, and means for connecting the supply line (6) to at least one phase of the multi-phase lighting rail (1).

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Montagesatz (1) zur Befestigung eines Audiomoduls (2) an einem Schienensystem. Das Audiomodul (2) weist eine Trägerstruktur (4) mit mindestens einem Aufhängungsorgan (5) und zumindest eine Zuleitung (6) für ein Audiosignal auf und der Montagesatz (1) weist Mittel zur Befestigung des Aufhängungsorgans (5) des Audiomoduls (2) an einer Mehrphasen-Lichtschiene (1) eines Lichtschienensystems, sowie Mittel zum Anschluss der Zuleitung (6) an zumindest eine Phase der Mehrphasen-Lichtschiene (1) auf.

IPC 8 full level

**H01R 25/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H01R 25/142** (2013.01)

Citation (applicant)

JP 2004032531 A 20040129 - SONY CORP

Citation (search report)

- [X] US 3832503 A 19740827 - CRANE R
- [X] US 2005169015 A1 20050804 - LUK JOHN F [US], et al
- [X] US 3639885 A 19720201 - YOSHIYA YOSHIO, et al
- [X] US 2009244925 A1 20091001 - SNAGEL PAUL [US], et al

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 2793324 A1 20141022**; WO 2014170256 A1 20141023

DOCDB simple family (application)

**EP 13164163 A 20130417**; EP 2014057496 W 20140414